

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈內容概不負責，
對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本公佈全部或任何
部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Niche-Tech Semiconductor Materials Limited

駿碼半導體材料有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8490)

**有關收購知識產權的重大關連交易
及
更改公開發售所得款項用途**

本公司的財務顧問



獨立董事委員會及獨立股東的
獨立財務顧問



衍丰企業融資有限公司

收購事項

於2023年6月14日，駿碼科技(香港)與BVI Holdings訂立該協議，據此，駿碼科技(香港)同意購買而BVI Holdings(作為實益擁有人)同意出售知識產權，總代價為38.0百萬港元，較初步估值折讓約4.3%。

知識產權包括COB封裝技術及FC-BGA封裝技術。

COB封裝技術為應用於板上芯片壓縮成型封裝的液體封裝膠的技術。董事會認為，COB封裝技術可採用用於Mini-LED行業的環氧樹脂瞬間固化技術。COB封裝技術由BVI Holdings開發，具有高韌性、低熱膨脹係數、高可靠性及低玻璃轉化溫度等特點。COB封裝技術適用於小間距RGB Mini-LED模組。

FC-BGA封裝技術為應用於倒裝芯片球柵陣列封裝的半固態封裝膠的技術。董事會認為，FC-BGA封裝技術通過改變樹脂、促進劑及多元醇的類型及結構，可改進用於封裝的環氧樹脂成型材料及提高成型工藝的持續性，並具有低熱膨脹係數、高可靠性及低玻璃轉化溫度等特點，適用於Mini-LED模組封裝的注塑工藝。

代價及付款

根據該協議，收購COB封裝技術及FC-BGA封裝技術分別為28.2百萬港元及9.8百萬港元。

因此，代價應為38.0百萬港元，應由駿碼科技(香港)以下列方式支付：

- (i) 12.0百萬港元代價已於該協議簽署日期支付予BVI Holdings作為按金；
- (ii) 12.0百萬港元代價須於股東特別大會上獲得獨立股東批准及就銀行融資獲得一間香港持牌銀行批准後以現金支付予BVI Holdings；
- (iii) 12.0百萬港元代價須於完成後以現金支付予BVI Holdings；及
- (iv) 餘下2.0百萬港元代價須於完成日期後三個月以現金支付予BVI Holdings。

更改所得款項用途

由於業務環境瞬息萬變，本集團將繼續為其產品開發及／或尋求新技術，以把握最新趨勢帶來的新機遇，尤其是增加半導體及Mini-LED顯示器封裝相關業務的市場份額。因此，董事會已決定分配更多資源以提供優質先進的產品，滿足本集團客戶對半導體封裝相關封裝膠不斷變化的需求。為此，董事會已決定將原用於(i)收購或投資鍵合線業務或相關業務；(ii)採購用於新生產線的機器及設備以及升級生產設施；及(iii)採購用於改善研發的機器及設備的未動用所得款項淨額約23.1百萬港元，重新分配至收購新知識產權(即收購事項)。

GEM上市規則的含義

BVI Chows持有BVI Holdings的100%全部已發行股本，並由執行董事、本公司執行主席及控股股東周博士直接及實益擁有40%，及由執行董事及控股股東周教授直接及實益擁有60%；BVI Holdings持有357,000,000股股份，佔本公司全部已發行股本約50.6%。因此，BVI Holdings為本公司的關連人士，因此，根據GEM上市規則第20章，收購事項構成本公司的關連交易。

由於有關該協議的最高適用比率(定義見GEM上市規則)超過25%但低於100%，根據GEM上市規則第19章，收購事項亦構成本公司的重大交易，須遵守申報、公佈及股東批准的規定。

周教授及周博士於收購事項擁有重大權益。周教授及周博士已就董事會批准該協議及據此擬進行的交易(包括收購事項)的決議案放棄投票。由於BVI Holdings為該協議及據此擬進行的交易的訂約方，其須於股東特別大會上就批准該協議及據此擬進行的交易的相關決議案放棄投票。

由全體獨立非執行董事組成的獨立董事委員會已告成立，以就(其中包括)該協議項下擬進行的交易(包括收購事項)的條款向股東提供意見。獨立董事委員會已委任衍丰企業融資為獨立財務顧問。

一份載有(其中包括)該協議條款的進一步資料、獨立董事委員會函件、來自衍丰企業融資的意見,連同就批准該協議及據此擬進行的交易(包括收購事項)召開股東特別大會通告的通函,預期將盡快並無論如何不遲於2023年7月6日(經考慮本公司編製供載入通函的相關資料所需的估計時間)寄發予股東。

收購事項

於2023年6月14日,駿碼科技(香港)與BVI Holdings訂立該協議,據此,駿碼科技(香港)同意購買而BVI Holdings(作為實益擁有人)同意出售知識產權。

該協議的主要條款概要如下:

日期

2023年6月14日

訂約方

- (i) 駿碼科技(香港),作為買家;及
- (ii) BVI Holdings,作為賣家。

買賣知識產權

根據該協議的條款及條件,BVI Holdings作為實益擁有人出售知識產權予駿碼科技(香港),駿碼科技(香港)將向BVI Holdings購買知識產權,且不附帶任何產權負擔。

知識產權

知識產權包括COB封裝技術及FC-BGA封裝技術。

COB封裝技術為製造應用於板上芯片壓縮成型封裝的液體封裝膠的新技術。董事會認為,COB封裝技術可採用用於Mini-LED行業的環氧樹脂瞬間固化技術。COB封裝技術由BVI Holdings開發,具有高韌性、低熱膨脹係數、高可靠性及低玻璃轉化溫度等特點。COB封裝技術適用於小間距RGB Mini-LED模組。

FC-BGA封裝技術為製造應用於倒裝芯片球柵陣列封裝的半固態封裝膠的新技術。董事會認為，FC-BGA封裝技術通過改變樹脂、促進劑及多元醇的類型及結構，可改進用於封裝的環氧樹脂成型材料及提高成型工藝的持續性，並具有低熱膨脹係數、高可靠性及低玻璃轉化溫度等特點，適用於Mini-LED模組封裝的注塑工藝。

代價及付款

根據該協議，收購COB封裝技術及FC-BGA封裝技術分別為28.2百萬港元及9.8百萬港元。因此，代價應為38.0百萬港元。

COB封裝技術及FC-BGA封裝技術的初步估值乃由獨立估值師於2023年4月30日根據成本法估值，分別約為29.5百萬港元及10.2百萬港元。代價較初步估值折讓約4.3%。

代價應由駿碼科技(香港)以下列方式支付：

- (i) 12.0百萬港元代價已於該協議簽署日期支付予BVI Holdings作為按金；
- (ii) 12.0百萬港元代價須於股東特別大會上獲得獨立股東批准及就銀行融資獲得一間香港持牌銀行批准後以現金支付予BVI Holdings；
- (iii) 12.0百萬港元代價須於完成後以現金支付予BVI Holdings；及
- (iv) 餘下2.0百萬港元代價須於完成日期後三個月以現金支付予BVI Holdings。

代價乃經駿碼科技(香港)及BVI Holdings公平磋商後釐定，並經參考(i)對本集團與使用知識產權相關的未來前景；(ii)初步估值；及(iii)下文「進行收購事項的理由及裨益以及更改所得款項用途」一節所列資料。

董事認為該協議的條款及條件(包括代價)按照正常商業條款進行，屬公平合理，符合本公司及其股東整體利益。

代價已決定以本集團的內部資源及銀行借款撥資。

該協議的條件及完成

該協議須待以下條件達成後方可完成：

- (i) 駿碼科技(香港)信納對知識產權的盡職審查結果；
- (ii) 駿碼科技(香港)信納獨立第三方估值專家進行的知識產權最終估值；
- (iii) 駿碼科技(香港)已就銀行融資獲得一間香港持牌銀行批准；及
- (iv) 本公司已獲得董事會(包括獨立非執行董事)及獨立股東於股東特別大會上的批准，以訂立該協議及據此擬進行的交易。

如上述條件未能於截止日期前達成，除若干仍然有效的條款外，該協議將終止並成為不可強制執行，惟有關終止將不得損害任何一方就另外一方先前違反該協議的權利及補救措施，且就收購事項向BVI Holdings支付的任何部份代價將於截止日期後五個營業日內退還予駿碼科技(香港)。

更改公開發售所得款項用途

於本公佈日期，未動用的所得款項淨額約為23.1百萬港元，佔所得款項淨額約27.7%。

由於業務環境瞬息萬變，本集團將繼續為其產品開發及／或尋求新技術，以把握最新趨勢帶來的新機遇，尤其是增加半導體及Mini-LED顯示器封裝相關業務的市場份額。因此，董事會已決定分配更多資源以提供優質先進的產品，滿足本集團客戶對半導體封裝相關封裝膠不斷變化的需求。為此，董事會已決定重新分配未動用的所得款項淨額至研發以用於收購知識產權。更改所得款項淨額用途的詳情如下：

| | 於先前 公佈日期 未動用經修訂 所得款項淨額 百萬港元 | 直至 本公佈 日期已動用 所得款項淨額 百萬港元 | 直至 本公佈 日期未動用 所得款項淨額 百萬港元 | 建議 更改所得 款項淨額分配 百萬港元 | 直至 本公佈 日期未動用 經修訂所得 款項淨額 百萬港元 | 建議 應用未動用 所得款項 淨額的預期 時間表 |
|--------------------------|---|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|---|-------------------------------------|
| 擴充產能及升級生產設施 | | | | | | |
| - 收購或投資鍵合線業務或相關業務 | 19.4 | - | 19.4 | (19.4) | - | - |
| - 採購用於加強質量控制的機器及設備 | 0.7 | (0.7) | - | - | - | - |
| - 採購用於新生產線的機器及設備以及升級生產設施 | 1.8 | (1.0) | 0.8 | (0.8) | - | - |
| 投放研發資源 | | | | | | |
| - 收購新知識產權 | 10.2 | (10.2) | - | 23.1 | 23.1 ^(附註) | 由本公佈日期起至2023年12月31日 |
| - 採購用於改善研發的機器及設備 | 3.0 | (0.1) | 2.9 | (2.9) | - | - |

| | 於先前 公佈日期 未動用經修訂 所得款項淨額 百萬港元 | 直至 本公佈 日期已動用 所得款項淨額 百萬港元 | 直至 本公佈 日期未動用 所得款項淨額 百萬港元 | 建議 更改所得 款項淨額分配 百萬港元 | 直至 本公佈 日期未動用 經修訂所得 款項淨額 百萬港元 | 建議 應用未動用 所得款項 淨額的預期 時間表 |
|---------------|---|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|---|-------------------------------------|
| - 委聘研發項目的外部顧問 | 1.5 | (1.5) | - | - | - | - |
| 增加銷售及營銷活動 | 2.3 | (2.3) | - | - | - | - |
| 總計 | 38.9 | (15.8) | 23.1 | - | 23.1 | |

根據上表，董事會已決定將原用於(i)收購或投資鍵合線業務或相關業務；(ii)採購用於新生產線的機器及設備以及升級生產設施；及(iii)採購用於改善研發的機器及設備的未動用所得款項淨額約23.1百萬港元，重新分配至收購新知識產權（即收購事項）。

進行收購事項的理由及裨益以及更改所得款項用途

本集團主要從事開發、製造及銷售半導體封裝材料。

收購事項

根據本公司截至2022年12月31日止年度的年報（「**2022年年報**」），本公司錄得總收益約217.9百萬港元，其中約106.0百萬港元來自銷售鍵合線，較2021年同期減少約56.5百萬港元或34.8%。有關減少主要由於國內疫情。同時，銷售封裝膠的收益由截至2021年12月31日止年度約76.6百萬港元增加約23.8百萬港元至截至2022年12月31日止年度約100.4百萬港元。封裝膠銷售增加主要由於國內市場需求增長。毛利率由截至2021年12月31日止年度約23.4%上升至截至2022年12月31日止年度約26.6%，主要由於毛利率較高的封裝膠產品的銷售增加。

本集團一直以來的業務戰略為通過提供優質先進的產品滿足客戶不斷變化的需求，從而繼續擴大客戶群。本集團持續開發及／或尋求新技術，為客戶提供更優質的產品，以應付其需求並加強其於LED行業的競爭能力。本集團亦考慮將客戶群從商用擴大至家電產品。擴大後的應用範圍將不僅包括機場及商場LED顯示屏等商業用途，亦將包括Mini-LED電視等家電產品。

中國Mini-LED市場近年來增長迅速。更多配備Mini-LED的家電產品相繼推出，包括電視及遊戲顯示器等。與傳統LED相比，Mini-LED體積更小，可更精準地控制顯示器的背光。Mini-LED提高對比度及亮度，提供更佳畫質。Mini-LED亦較傳統LED更節能，故可延長便攜式設備的電池壽命。預期未來Mini-LED將廣泛用於國內電子產品的生產。

鑑於Mini-LED市場持續增長，董事認為，收購事項將使本集團能夠把握Mini-LED行業預期市場增長所帶來的機遇，並通過豐富其產品結構保持本集團在封裝膠市場的競爭力。

利用該知識產權，本集團可為客戶生產出兩種類型的封裝劑，用於兩種類型的Mini-LED封裝。

COB封裝技術為製造應用於板上芯片壓縮成型封裝的液體封裝膠的新技術。COB封裝技術可採用適用於Mini-LED封裝的環氧樹脂瞬間固化技術，並具有高韌性、低熱膨脹係數、高可靠性及低玻璃轉化溫度等特點。

FC-BGA封裝技術為製造應用於倒裝芯片球柵陣列封裝的半固態封裝膠的新技術。FC-BGA封裝技術通過改變樹脂、促進劑及多元醇的類型及結構，改進用於封裝的環氧樹脂成型材料，並具有低熱膨脹係數、高可靠性及低玻璃轉化溫度等特點，適用於Mini-LED模組封裝的注塑工藝。

鑒於LED行業技術的不斷變化以及電子產品的日益小型化，不斷加強及開發封裝膠極為重要。然而，開發一種新型封裝膠可能會耗費大量成本及時間。基於知識產權的新型封裝膠是一套完整及完全開發技術，將使本集團可在緊接該協議完成後立即開始生產新型封裝膠。因此，董事認為，收購事項可以節省本集團的時間與精力，使其無需自行開發具有類似於知識產權特性的封裝膠。

更改所得款項用途

董事認為，在保持在中國鍵合線市場競爭力的同時，本集團應將更多資源分配予封裝膠市場的發展。為使本集團更佳地利用財務資源，本集團已決定將未動用所得款項淨額約23.1百萬港元重新分配至本集團的研發活動。

為進一步提高本集團在封裝膠市場的競爭力，本集團已決定將重新分配的所得款項淨額用於收購知識產權。董事認為，有關新封裝膠技術的收購事項將節省本集團用於自身研發的時間與精力，並使本集團能夠立即開始生產規格更佳、成本更低的新產品，以滿足Mini-LED市場日益增長的需求。

鑒於上述情況，董事認為，上述更改未動用所得款項淨額有利於本集團的長期業務發展，且亦是對未動用所得款項淨額更恰當的利用。董事會將以本公司及其股東的利益為重，密切關注未動用所得款項淨額的使用情況。董事會確認，本公司在招股章程及已發表季度、中期及年度報告中所述的本集團的業務性質沒有重大變化。董事會認為，建議更改所得款項淨額的用途不會對本集團的運營及業務產生任何重大不利影響，並且符合本公司及股東的整體最佳利益。

BVI HOLDINGS的資料

BVI Holdings的主要業務為投資控股。於本公佈日期，其由周博士最終擁有40%，及由周教授最終擁有60%。

GEM上市規則的含義

BVI Chows持有BVI Holdings的100%全部已發行股本，並由執行董事、本公司執行主席及控股股東周博士直接及實益擁有40%，及由執行董事及控股股東周教授直接及實益擁有60%；及BVI Holdings持有357,000,000股股份，佔本公司全部已發行股本約50.6%。因此，BVI Holdings為本公司的關連人士，因此，根據GEM上市規則第20章，收購事項構成本公司的關連交易。

周教授及周博士於收購事項擁有重大權益。周教授及周博士已就董事會批准該協議及據此擬進行的交易(包括收購事項)的決議案放棄投票。由於BVI Holdings為該協議及據此擬進行的交易的訂約方，其須於股東特別大會上就批准該協議及據此擬進行的交易的相關決議案放棄投票。

由於有關該協議的最高適用比率(定義見GEM上市規則)超過25%但低於100%，根據GEM上市規則第19章，收購事項亦構成本公司的重大交易，須遵守申報、公佈及股東批准的規定。

由全體獨立非執行董事組成的獨立董事委員會已告成立，以就(其中包括)該協議項下擬進行的交易(包括收購事項)的條款向股東提供意見。獨立董事委員會已委任衍丰企業融資為獨立財務顧問。

一份載有(其中包括)該協議條款的進一步資料、獨立董事委員會函件、來自衍丰企業融資的意見，連同就批准該協議及據此擬進行的交易(包括收購事項)召開股東特別大會通告的通函，預期將盡快並無論如何不遲於2023年7月6日(經考慮本公司編製供載入通函的相關資料所需的估計時間)寄發予股東。

釋義

在本公佈內，除非文義另有指明，否則下列詞語具以下涵義：

| | | |
|---------------------|---|---|
| 「收購事項」 | 指 | 根據該協議收購知識產權 |
| 「該協議」 | 指 | 駿碼科技(香港)與BVI Holdings就收購事項而於2023年6月14日訂立的協議 |
| 「銀行融資」 | 指 | 由一間香港持牌銀行將予授出最高15.0百萬港元的銀行融資，用於收購知識產權 |
| 「董事會」 | 指 | 董事會 |
| 「營業日」 | 指 | 除星期六、星期日及香港公眾假期以外的任何日子 |
| 「BVI Chows」 | 指 | Chows Investment Group Limited，一間於2016年9月28日於英屬處女群島註冊成立的有限公司，分別由周博士及周教授直接及實益擁有40%及60% |
| 「BVI Holdings」或「賣家」 | 指 | 駿碼科技投資控股有限公司，一間於2016年10月14日於英屬處女群島註冊成立的有限公司，由BVI Chows直接、實益及全資擁有 |
| 「COB封裝技術」 | 指 | 製造應用於板上芯片壓縮成型封裝的液體封裝膠的新技術 |
| 「本公司」 | 指 | 駿碼半導體材料有限公司，一間於開曼群島註冊成立的有限公司，其股份於GEM上市(股份代號：8490) |
| 「完成」 | 指 | 根據該協議完成收購事項 |
| 「關連人士」 | 指 | 具GEM上市規則賦予之涵義 |
| 「代價」 | 指 | 知識產權的總代價38.0百萬港元 |

| | | |
|-------------------|---|--|
| 「控股股東」 | 指 | 具GEM上市規則所賦予的涵義，包括有權於本公司股東大會行使30%或以上投票權或可控制董事會大部分成員組成的任何人士或一組人士 |
| 「董事」 | 指 | 本公司董事 |
| 「周博士」 | 指 | 周博軒博士，本公司執行董事、執行主席兼控股股東 |
| 「股東特別大會」 | 指 | 本公司將予召開的股東特別大會，以考慮並酌情批准有關該協議及據此擬進行的交易(包括收購事項)的普通決議案 |
| 「FC-BGA封裝技術」 | 指 | 製造應用於倒裝芯片球柵陣列封裝的半固態封裝膠的新技術 |
| 「GEM」 | 指 | 聯交所GEM |
| 「GEM上市規則」 | 指 | GEM證券上市規則 |
| 「本集團」 | 指 | 本公司及其附屬公司 |
| 「港元」 | 指 | 香港元，香港法定貨幣 |
| 「香港」 | 指 | 中國香港特別行政區 |
| 「衍丰企業融資」或「獨立財務顧問」 | 指 | 衍丰企業融資有限公司，為根據證券及期貨條例可進行第6類(就機構融資提供意見)受規管活動的持牌法團，即就(其中包括)該協議項下擬進行的交易(包括收購事項)的條款是否屬公平合理，以及有關條款是否符合本公司及股東的整體利益向獨立董事委員會及獨立股東提供意見的獨立財務顧問 |

| | | |
|-----------------|---|--|
| 「獨立董事委員會」 | 指 | 由全體獨立非執行董事(即吳宏偉教授、戴進傑先生及潘禮賢先生)組成的董事會獨立委員會，以就該協議項下擬進行的交易(包括收購事項)向股東提供意見 |
| 「獨立股東」 | 指 | 無須於批准該協議及據此擬進行的交易(包括收購事項)的股東特別大會上放棄投票的股東 |
| 「獨立估值師」 | 指 | 仲量聯行企業評估及諮詢有限公司，由本公司就知識產權進行估值而委聘的獨立估值師 |
| 「知識產權」 | 指 | COB封裝技術及FC-BGA封裝技術的知識產權 |
| 「截止日期」 | 指 | 該協議的截止日期，將為2023年11月30日下午4時正或之前(或訂約方可能同意的較後日期，即香港銀行開放營業的日子，惟星期六、星期日或公眾假期除外) |
| 「Mini-LED」 | 指 | 迷你發光二極管 |
| 「所得款項淨額」 | 指 | 公開發售所得款項淨額 |
| 「駿碼科技(香港)」或「買家」 | 指 | 駿碼科技(香港)有限公司，一間於2012年4月26日於香港註冊成立的有限公司，為本公司間接全資附屬公司 |
| 「中國」 | 指 | 中華人民共和國，就本公佈而言，不包括香港、澳門特別行政區及台灣 |
| 「初步估值」 | 指 | 由獨立估值師編製有關知識產權的初步估值 |
| 「先前公佈」 | 指 | 本公司日期為2021年7月30日的公佈，內容有關收購知識產權及更改所得款項淨額用途 |

| | | |
|--------|---|-------------------------|
| 「周教授」 | 指 | 周振基教授，本公司執行董事及控股股東 |
| 「招股章程」 | 指 | 本公司日期為2018年5月17日的招股章程 |
| 「股份」 | 指 | 本公司已發行股本中每股面值0.01港元之普通股 |
| 「股東」 | 指 | 股份持有人 |
| 「股份發售」 | 指 | 招股章程所述的公開發售及股份配售 |
| 「聯交所」 | 指 | 香港聯合交易所有限公司 |

承董事會命
駿碼半導體材料有限公司
執行主席兼執行董事
周博軒

香港，2023年6月14日

於本公佈日期，執行董事為周博軒博士、周振基教授及石逸武先生，非執行董事為李超凡先生及獨立非執行董事為吳宏偉教授、潘禮賢先生及戴進傑先生。

本公佈所載資料(董事願共同及個別地承擔全部責任)乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料。各董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公佈所載資料在各重大方面均為準確及完整，且無誤導或欺詐成分；及並無遺漏任何其他事項致使本公佈所載任何陳述或本公佈產生誤導。

本公佈將由刊登日期起計最少七日於聯交所網站www.hkexnews.hk的「最新上市公司公告」頁內刊載。本公佈亦將於本公司網站www.nichetech.com.hk刊載。